

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和3年10月28日(2021.10.28)

【公表番号】特表2020-537330(P2020-537330A)

【公表日】令和2年12月17日(2020.12.17)

【年通号数】公開・登録公報2020-051

【出願番号】特願2020-514197(P2020-514197)

【国際特許分類】

H 01 L 21/607 (2006.01)

H 01 R 4/02 (2006.01)

H 01 R 43/02 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/607 A

H 01 L 21/607 B

H 01 R 4/02 C

H 01 R 43/02 B

【手続補正書】

【提出日】令和3年9月16日(2021.9.16)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0007

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0007】

端子と基板との間に電気相互接続を形成するために使用できる様々な方法がある。超音波溶接は、強固でよく制御される比較的高速で低コストのプロセスであるため、特に魅力的なオプションとみなされる。さらに、超音波溶接は、比較的環境的にクリーンなプロセスであり、通常、損傷を与える溶剤の使用を含まない。

この出願の発明に関連する先行技術文献情報としては、以下のものがある（国際出願日以降国際段階で引用された文献及び他国に国内移行した際に引用された文献を含む）。

(先行技術文献)

(特許文献)

(特許文献1) 国際公開第2016/199621号

(特許文献2) 特開2007-005474号公報

(特許文献3) 特開2014-056917号公報

(特許文献4) 米国特許出願公開第2016/0133712号明細書

(特許文献5) 米国特許出願公開第2013/0049201号明細書